Willkommen bei O-Leading

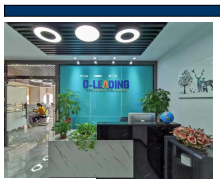
O-Leading ist bestrebt, Ihr One-Stop-Lösungspartner in der EMS-Lieferkette zu sein, einschließlich Leiterplattenbau, Leiterplattenbestückung und Leiterplattenbestückung (PCBA). Wir bieten stangs der fortschrittlichsten Leiterplattentechnologien, einschließlich HDI-Leiterplatten, Mehrschicht-Leiterplatten und starrflexiblen Leiterplatten Wir können von schnellen Prototyp bis zur mittleren und Massenproduktion unterstützen.
Im Allgemeinen sind unsere globalen Kunden von unseren Dienstleistungen sehr beeindruckt: schnelle Reaktion, wettbewerbsfähiger Preis und Qualitätssicherung. Die Bereitstellung eines vertrieblichen technischen Service und einer Gesamtlösung ist der Weg nach vorne. Lets discuss your project or inquiry
Mit Blick auf die Zukunft wird sich O-Leading weiv immer auf die Innovation und Entwicklung der Elektronikfertigungstechnologie konzentrieren und sich konsequent am PCB- und PCBA-One-Stop-Service beteiligen, um erstklassige Services bereitzustellen und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen.
BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: https://www.o-leading.com/

Produktbeschreibung

Herkunftsort:	Guangdong China (Festland)
Markenname:	O-Leading
Basismaterial:	FR-4, Aluminium
Anzahl der Schichten:	1-3 Lagen
Maximal. Leiterplattenmaße:	500 mm
Minimal. Zeilenabstand:	0.2 mm
Preis:	0.1 x 0.10
Minimal. Lochgröße:	0.2 mm
Farbe:	Grün, rot, gelb, schwarz, weiß
Kupferdicke:	0.5 Unzen-3 Unzen
MOQ:	10 Stück
Produktbezeichnung:	Power Bank Platine Hauptplatine PCBA Hersteller
Design-Typ:	Kundenanforderung
Anwendung:	Industrielle Steuerplatine
Oberflächenveredelung:	Immersionsgold, OSP, bleifreies HASL
Farbe:	Grün, rot, gelb, schwarz, weiß
Anwendbar auf:	LED, Handy, Klimaanlagen, Waschmaschinen
Zertifikate:	ISO9001, UL, RoHS, SGS01-014-23 01a2
Q CTN:	10PCS-100PCS
Gewicht:	0.01 kg bis 5 kg

OEM PCB Board Hersteller China

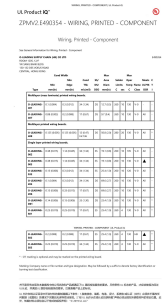
Unser Team



Factory PCB

Factory SMT

Zertifizierungen



Verpackung & Lieferung

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	16 days	24 days

Prozessfähigkeit

Produktionsmöglichkeiten für Leiterplatten
Layer Count: 1Layer-16Layer
Fertige Kupferdicke: 1 / 2oz-12oz
Min. Linienbreite / Abstand innen: 3.0 mil / 3.0 mil
Min. Linienbreite / Abstand außen: 4.0 mil/ 4.0 mil
Maximale Plattenfläche: 500 mm
Plattendicke: 0.2 mm - 5.0 mm
Maximale Panelgröße (2oS): 635 * 1500 mm
Minimale Bohrlochgröße: 6mil
Plated Hole Tolerance: +/- 3mil
Mind / Bunterlaubnis: 3.0 mil
Slot Fräsung / Fräsen: CNC routen/ JK
Basismaterial: FR-4, PN-deigh Tg,Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid, Schwerer Kupfer
Oberflächenbeschaffenheit: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Silberoäber,Immersionzinne, Goldfinger, Carbon-Tinte

SMT-Produktionskapazitäten
Leiterplattenmaterial:FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis
Maximale Leiterplattengröße: 510 x 460 mm
Min. Leiterplatte: 50 x 50 mm
Leiterplattendicke: 0.3 mm - 5.0 mm
Plattendicke: 0.5-4 mm
Min. Komponentengröße: 0201
Standard-Chipgrößenkomponente: 0603 und größer
Maximale Chipgrößenkomponente: 55 mm
Minimaler Stiftgrößenabstand: 0.2 mm
Min. BGA-Bällebabstand: 0.4 mm
Platzierungsmaßgenau: +/- 0.03 mm